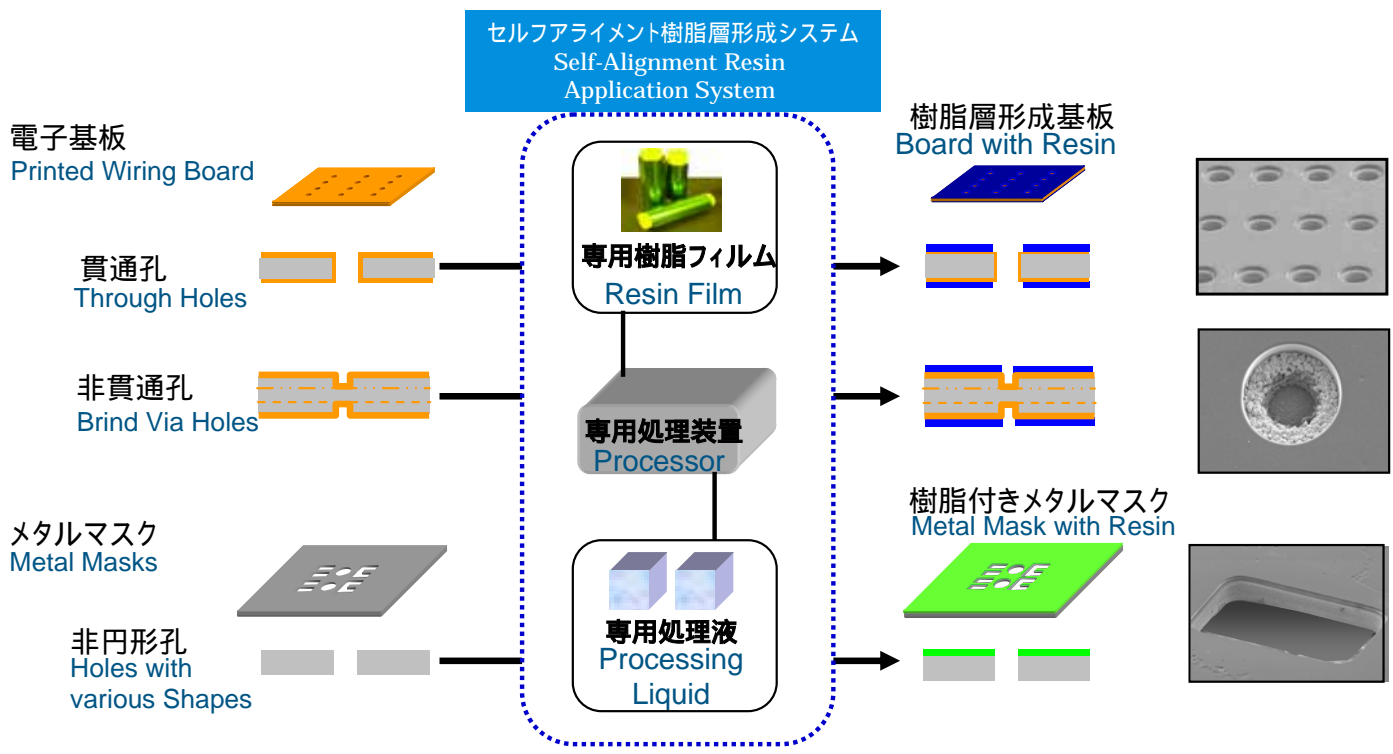


セルフアライメント樹脂層形成技術

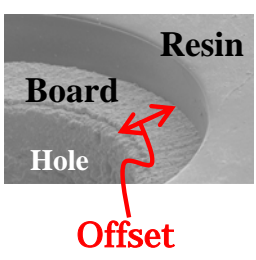
Self-Alignment Resin Application Technique

種々の基板開口部に位置ずれなく、機能性樹脂層を形成できます。
Resin can be applied on the board with no positioning error.



特徴 Features

位置合わせ作業不要！ Self-Alignment - No Positioning Error Occurs
 オフセット幅コントロール可能！ Offset Controllable
 (-10 μm ~ +100 μm)
 各種機能性樹脂層可能！ Versatility with Resin Modification
 (メッキレジスト性、感光性、耐薬品性等)
 Possible Property : Photosensitivity, Resistance to Various Chemicals, etc

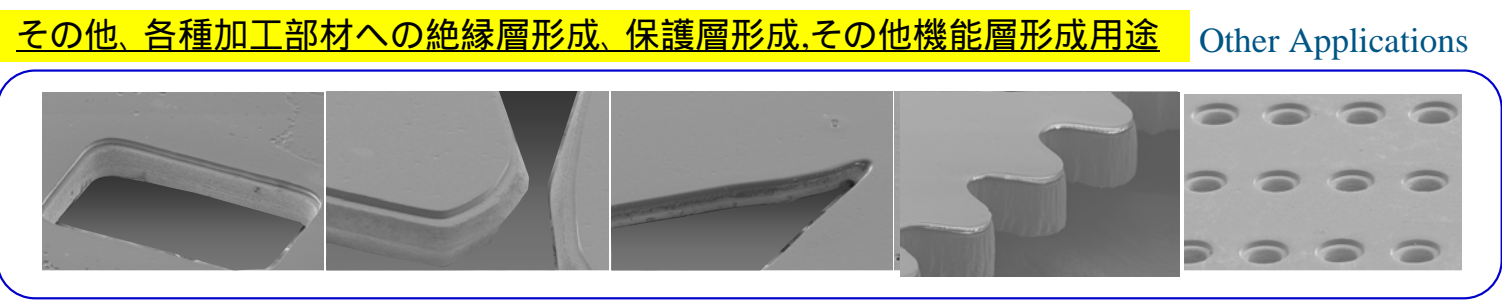
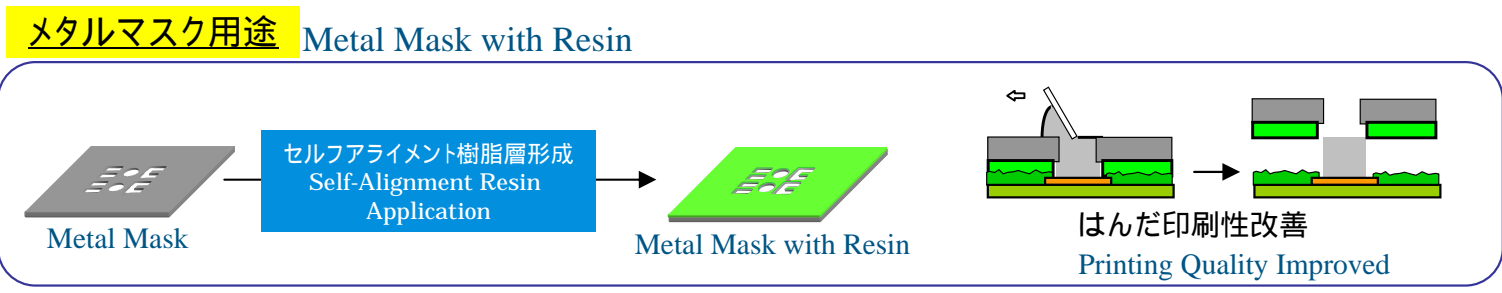
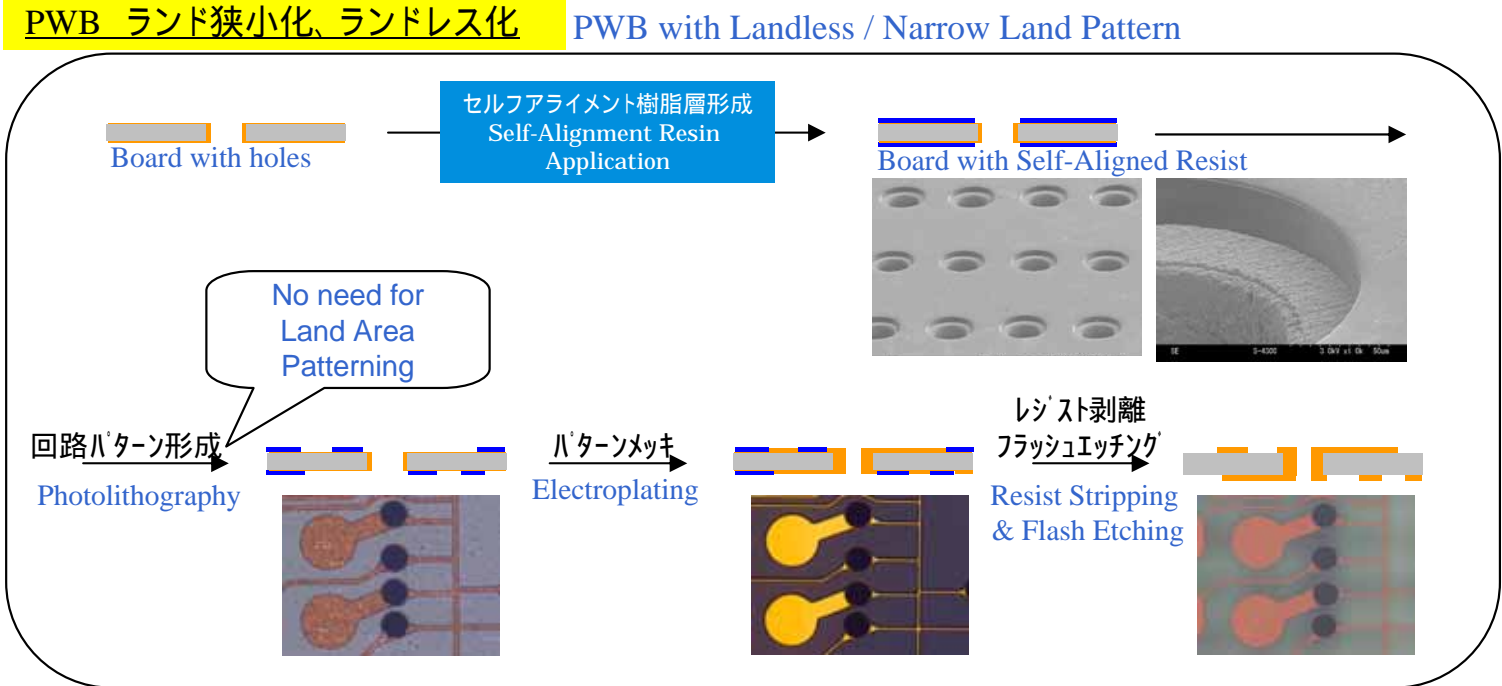


応用例 Application

プリント基板 (狭小ランド化、ランドレス化、穴内選択めっき)
 樹脂付きメタルマスク、コンタクトプローブ、ノズルプレート、etc
 PWB (Landless / Narrow-Land Pattern, Selective Hole Plating)
 Metal Mask, Contact Probe, Nozzle Plate, etc

その他用途、
ご相談ください！

応用例
Application



標準仕様例

- ・対応基材種類 : プリント基板(スルーホール、ピアホール)、金属板、他
- ・対応基材厚 : 0.03mmt ~ 0.8mmt
- ・対応開口サイズ : 50 μm 以上
- ・オフセット幅 : -10 μm ~ +100 μm
- ・樹脂層厚み : 5 μm ~ 50 μm

* 詳細は、お打ち合わせの上、対応させていただきます。
上記仕様にかかわらず、ご要望をお聞かせ下さい。